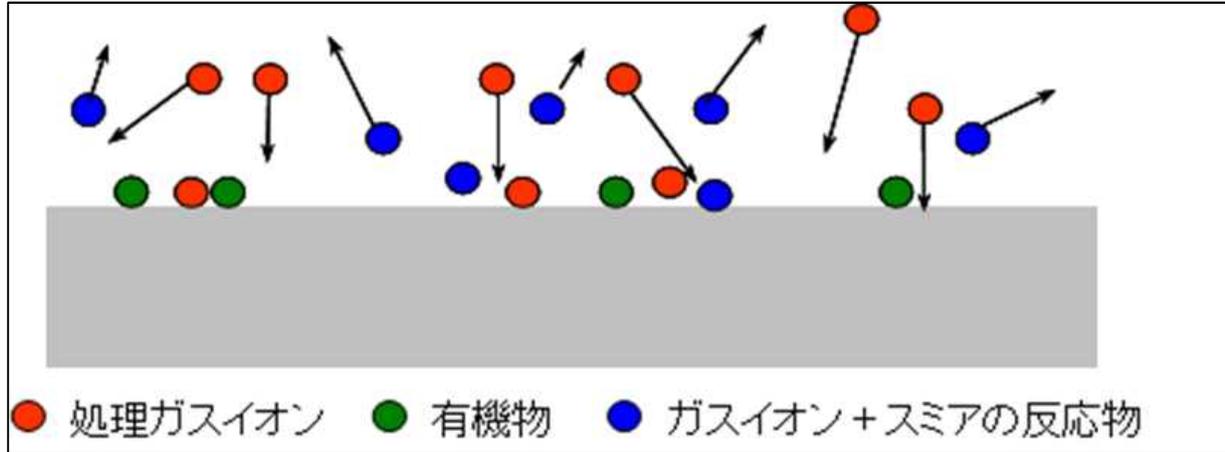


JCUプラズマ処理装置TAIKAI

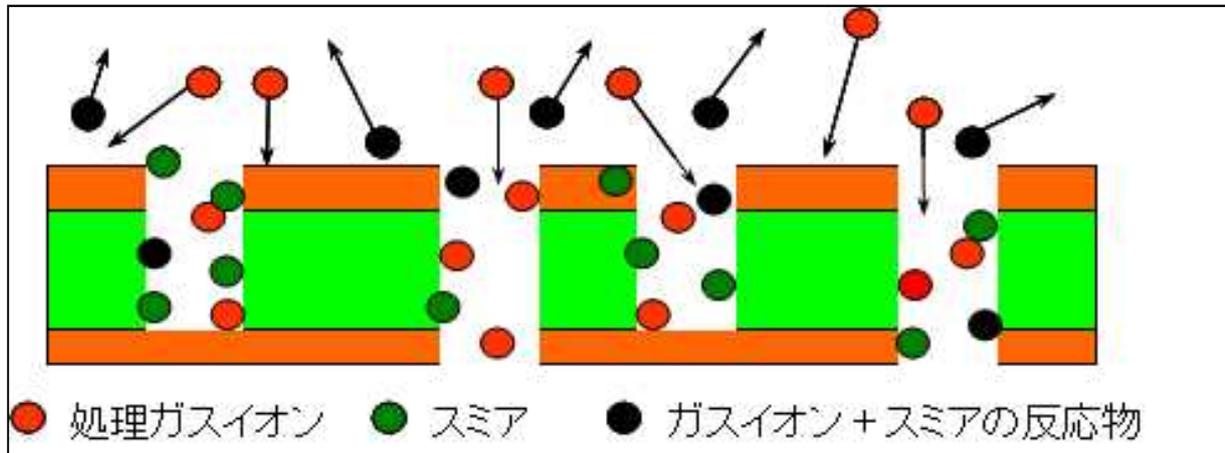
株式会社JCU

プラズマ処理とは

表面改質・クリーニング



デスミア・デスカム



O_2 : 有機物酸化

Ar: 物理的エッチング

H_2 : 酸化除去(還元)

CF_4+O_2 : 高速アッシング

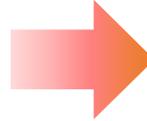
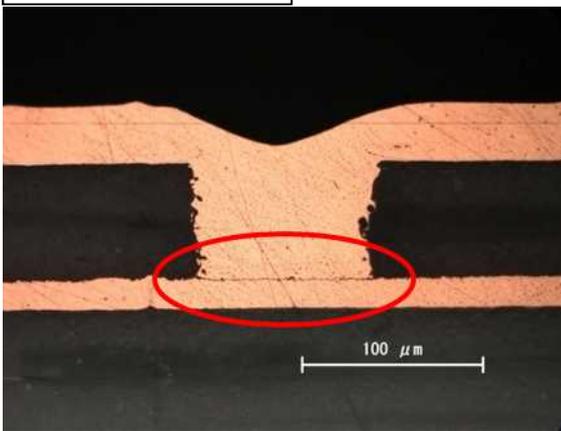


プラズマ放電中のチャンパー内の様子

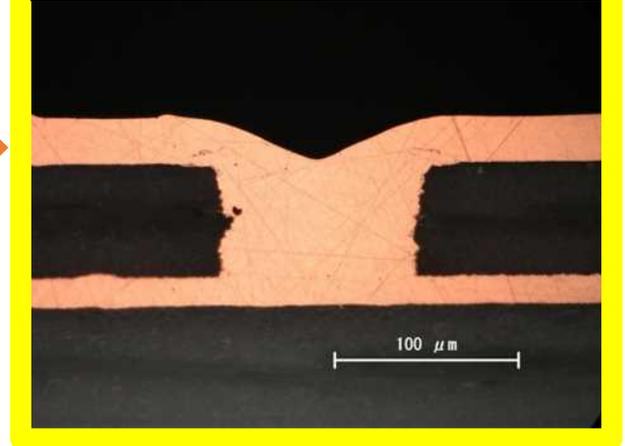
ドライデスミア(ピアホール)

めっき後断面

プラズマ未処理

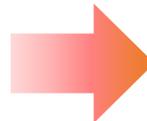
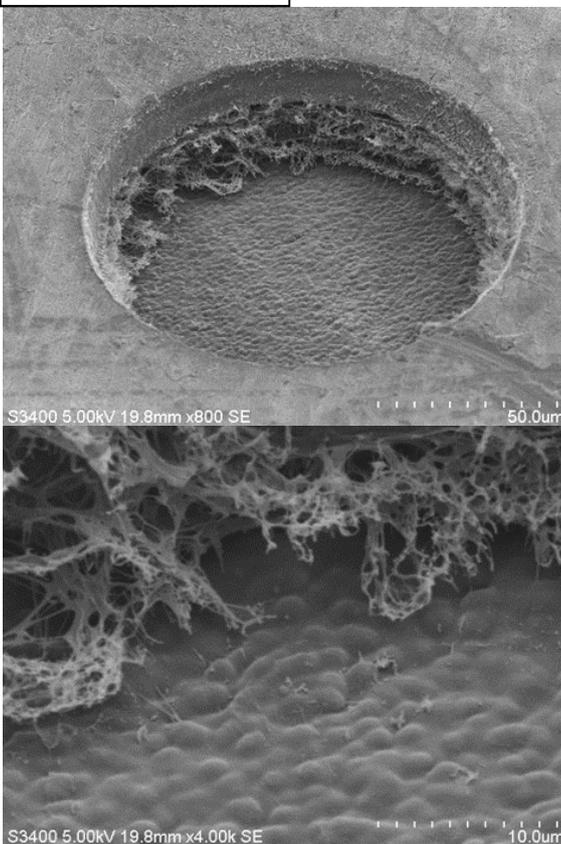


プラズマ処理後

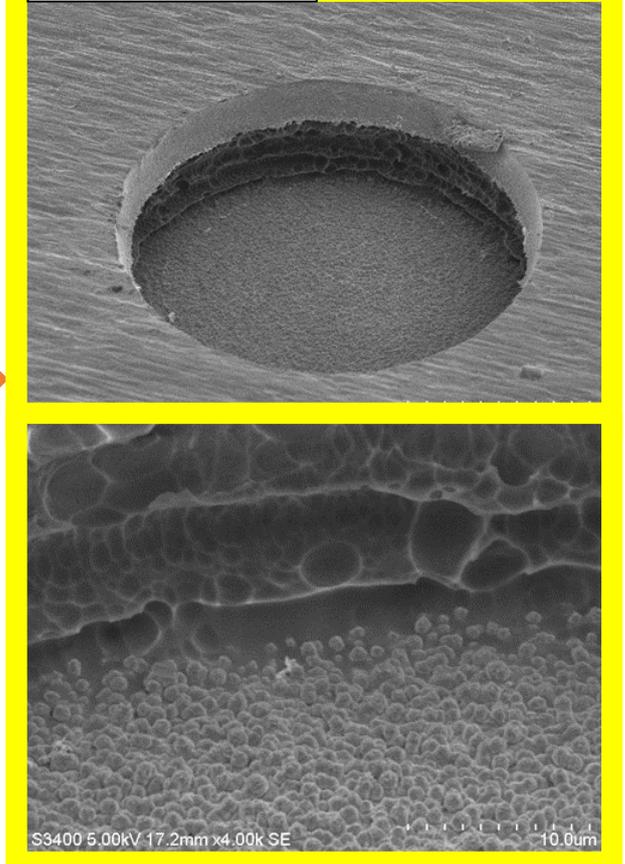


SEM観察

プラズマ未処理



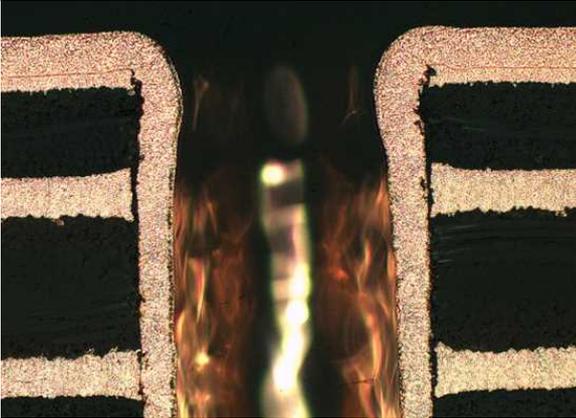
プラズマ処理後



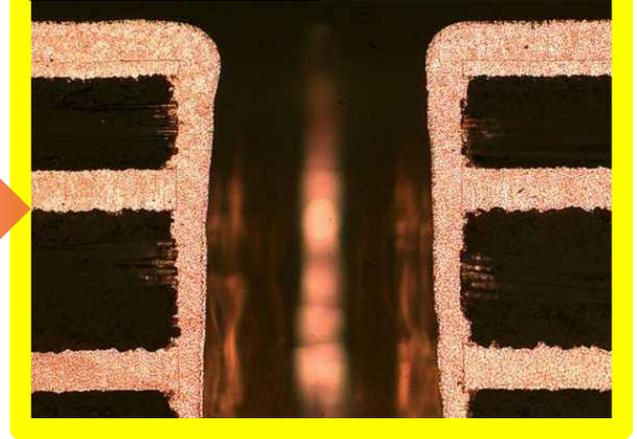
ドライデスミア(スルーホール)

めっき後断面

プラズマ未処理

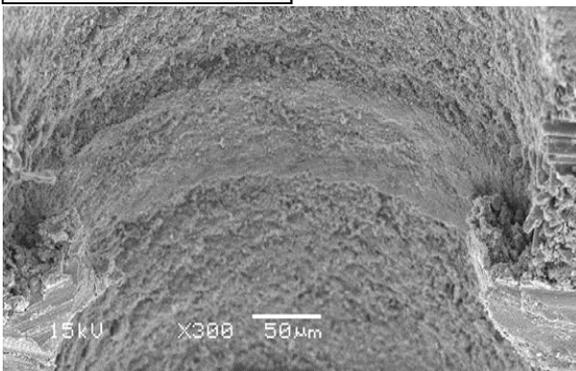


プラズマ処理後

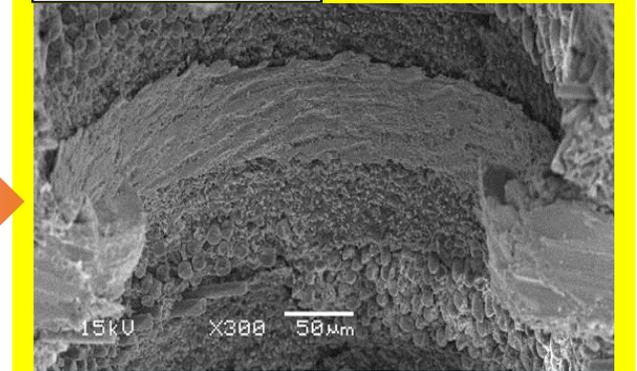


SEM観察

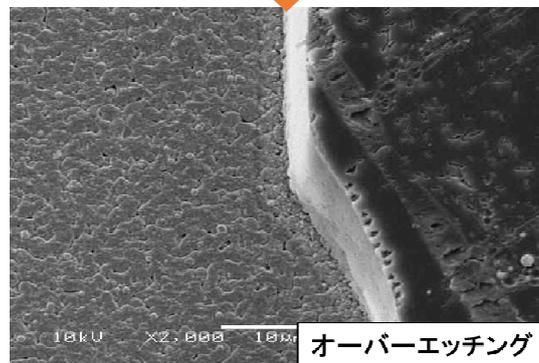
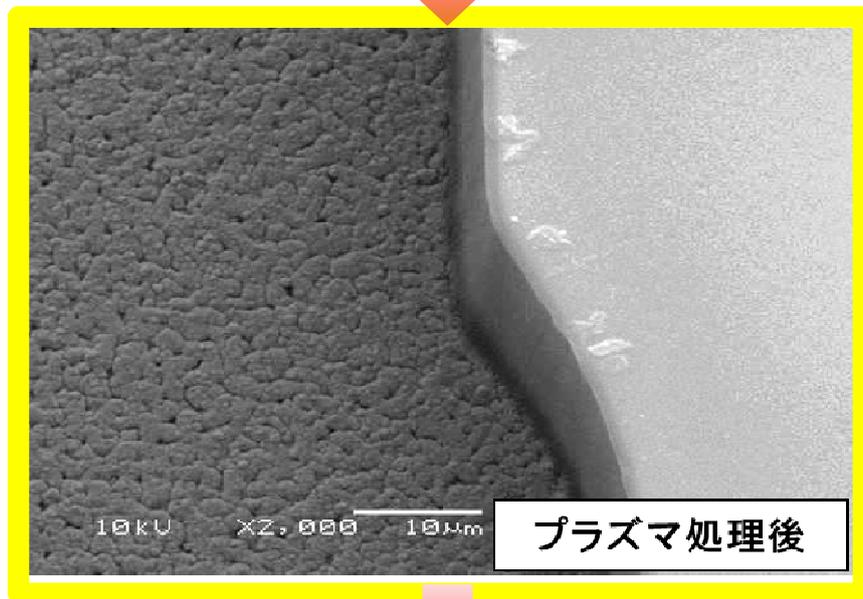
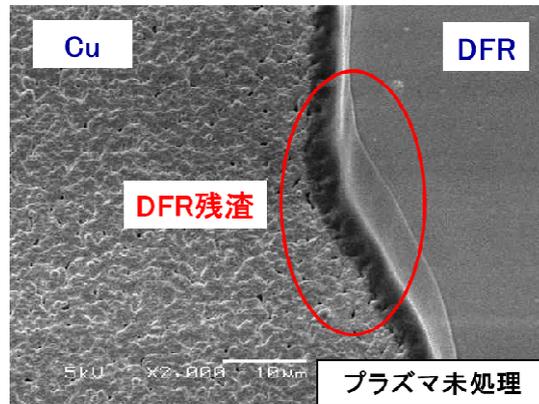
プラズマ未処理



プラズマ処理後



ドライデスカム

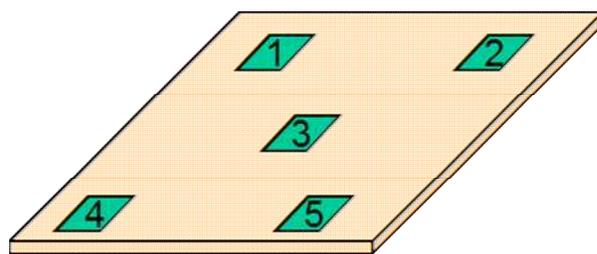
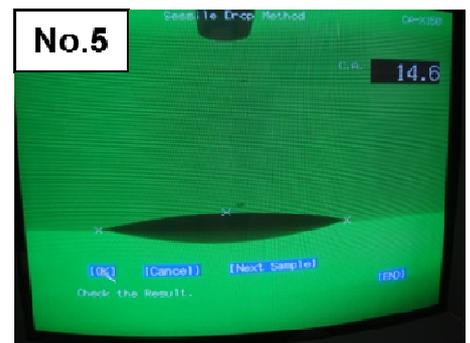
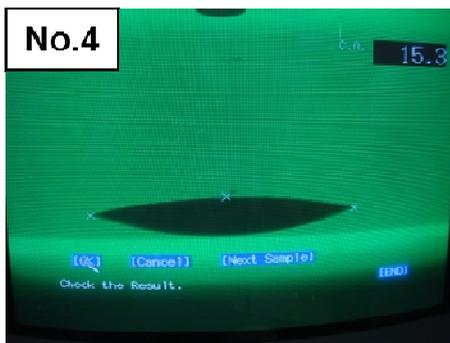


ドライフィルムの現像残渣除去により
微細回路形成が可能！

親水化



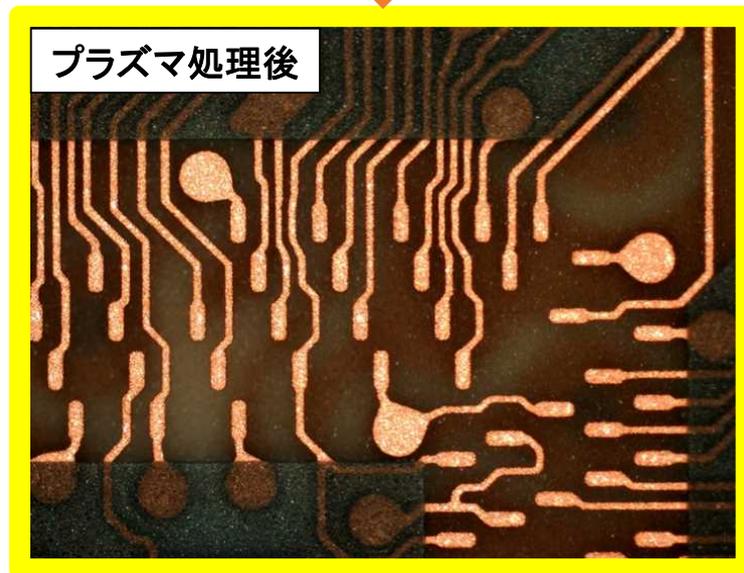
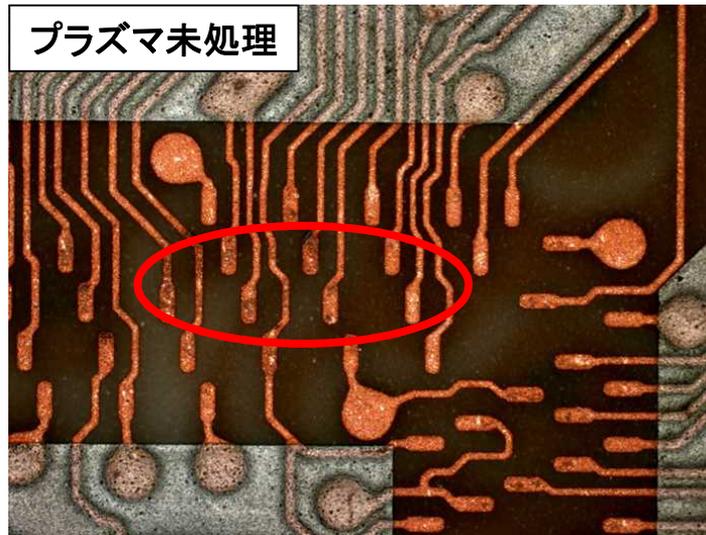
接触角: 71.1°



樹脂・金属上に親水基を形成することで
微細回路内へのめっき液の浸透を促進！

クリーニング

金属(Cu)上の有機物残渣除去



金めっきなど
後工程での表面処理の歩留まり改善に有効！

TAIKAIラインナップ

バッチ式装置



枚葉式自動搬送装置



ロール to ロール自動搬送装置



研究開発用小型機



特徴

バッチ式装置

- ・複数枚の基板を同時に処理できるので、生産効率が高い。
- ・可変治具の使用で、各種基板サイズの処理が可能。

枚葉式自動搬送装置

- ・自動搬送に対応し、ヒューマンエラーの発生を抑制。
- ・基板一枚処理のため、面内均一性が高い。

ロール to ロール自動搬送装置

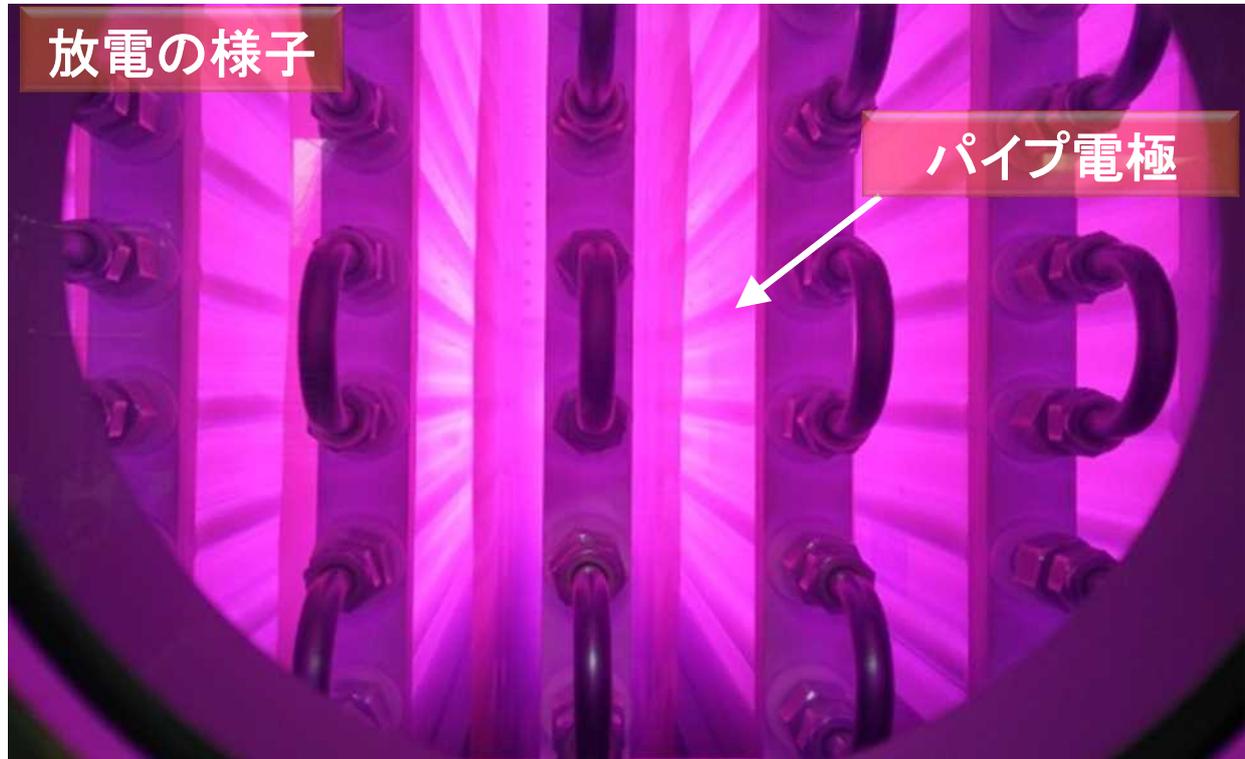
- ・FCCLロールを切断することなく連続処理が可能。
- ・低温下での高速エッチングによるデスマリア、デスカム処理。

研究開発用小型機

- ・安価で省スペース。
- ・少量生産、開発用途でのプラズマ処理に最適。

参考資料

電極の特徴



- ・パイプ電極により電極内の圧力分布が均一。
- ・電極内に冷却水を流すことで低温下でのプラズマ処理が可能。
- ・チャンバー及び電極に、放電効率の高い金属材料を採用。

さまざまな基材に適したプラズマ処理が可能！

株式会社JCU 装置営業部 装置営業課
東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 4階
TEL: 03-6895-7016